#### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 05232706 A

(43) Date of publication of application: 10.09.93

(51) Int. CI G03F 7/039
G03F 7/004
G03F 7/004
G03F 7/028
G03F 7/038
H01L 21/027

(21) Application number: 04073169
(22) Date of filing: 25.02.92

(71) Applicant: JAPAN SYNTHETIC RUBBER CO LTD

(72) Inventor: MURATA MAKOTO

MURATA MAKOTO OTA TOSHIYUKI ISAMOTO YOSHITSUGU

MIURA TAKAO

#### (54) RADIATION SENSITIVE RESIN COMPOUND

#### (57) Abstract:

PURPOSE: To provide a radiation sensitive resin compound, which presents excel lent developing performance, pattern configuration, resolution, adhesiveness, focusing tolerance, and film remaining, ensures good stability, and can serve favorably for irradiation with radiations of wavelength under far-infrared ray, for example, excimer laser.

CONSTITUTION: A radiation sensitive resin compound comprises a positive type radiation sensitive resin compound and a negative type radiation sensitive resin

compound, wherein the former is composed of an alkaline soluble resin (1), radiation sensitive acid forming agent (2), a compound (3) having a nature of controlling the alkaline solubility of the alkaline soluble resin (1) and exhibiting a nature of diminishing or nullifying the alkaline solubility control effect of the resin (1) upon being dissolved under existence of acids or of accelerating the alkaline solubility of the resin (1) and (4): a nitrogen-including basic compound; and the latter composed of the same items: (1), (2), (4), and a compound (3) which is of nature as cross-linkeying the alkaline soluble resin (1) under existence of acids.

COPYRIGHT: (C)1993, JPO& Japio

#### (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平5-232706

(43)公開日 平成5年(1993)9月10日

(51)lnt.Cl. <sup>5</sup> G 0 3 F	7/039 7/004 7/028	識別記号 5 0 1 5 0 1 5 0 3	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
	17026		7352—4M		21/30 301 R R 請求項の数3(全 18 頁) 最終頁に続く
(21)出願番号	<del>]</del>	特願平4-73169		(71)出願人	000004178 日本合成ゴム株式会社
(22)出願日		平成 4年(1992) 2	月25日	(72)発明者	東京都中央区築地 2 丁目11番24号 村田 誠
				(72)発明者	東京都中央区築地二丁目11番24号 日本合成ゴム株式会社内 大田 利幸
				(12)光明石	スロー刊手 東京都中央区築地二丁目11番24号 日本合 成ゴム株式会社内
				(72)発明者	勇元 喜次 東京都中央区築地二丁目11番24号 日本合 成ゴム株式会社内
				(74)代理人	

## (54)【発明の名称】 感放射線性樹脂組成物

#### (57)【要約】 (修正有)

【構成】(1)アルカリ可溶性樹脂、(2)感放射線性酸形成剤、(3)(1)のアルカリ可溶性樹脂のアルカリ溶解性を制御する性質を有し、そして酸の存在下で分解されて(1)のアルカリ可溶性樹脂のアルカリ溶解性制御効果を低下もしくは消失する性質または(1)のアルカリ可溶性樹脂のアルカリ溶解性を促進する性質を発現する化合物、および(4)含窒素塩基性化合物より構成されるポジ型感放射線性樹脂組成物 あるいは

(1)、(2)、(4)は上記と同じで(3)酸の存在下で(1)のアルカリ可溶性樹脂を架橋する化合物より構成されるネガ型感放射線性樹脂組成物。

【効果】現像性、パターン形状、解像度、接着性、フォーカス許容性および残膜性に優れ、安定性も良好であり、特にエキシマーレーザーなどの遠紫外線以下の波長の放射線の照射にも好適に使用される感放射線性樹脂組成物を提供する。

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 (1) アルカリ可溶性樹脂、(2) 感放射線性酸形成剤、(3) (1) のアルカリ可溶性樹脂のアルカリ溶解性を制御する性質を有し、そして酸の存在下で分解されて(1) のアルカリ可溶性樹脂のアルカリ溶解性制御効果を低下もしくは消失する性質または

(1)のアルカリ可溶性樹脂のアルカリ溶解性を促進する性質を発現する化合物、および(4)含窒素塩基性化合物を含有することを特徴とするポジ型感放射線性樹脂組成物。

【請求項2】 (1) 置換メチル基、1-置換エチル基、ゲルミル基、アルコキシカルボニル基およびアシル基から選ばれる少なくとも1種の酸解離性基を有するアルカリ不溶性または難溶性樹脂で、上記の基が酸解離したときにアルカリ可溶性である樹脂、(2) 感放射線性酸形成剤、および(3) 含窒素塩基性化合物を含有することを特徴とするポジ型感放射線性樹脂組成物。

【請求項3】 (1) アルカリ可溶性樹脂、(2) 感放射線性酸形成剤、(3) 酸の存在下で(1) のアルカリ可溶性樹脂を架橋する化合物、および(4) 含窒素塩基性化合物を含有することを特徴とするネガ型感放射線性樹脂組成物。

## 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、感放射線性樹脂組成物に関する。さらに詳しくは、特にエキシマレーザーなどの遠紫外線の如き放射線を用いる微細加工に有用なレジストとして好適な感放射線性樹脂組成物に関する。

## [0002]

【従来の技術】集積回路の製造に代表される微細加工の分野においては、集積回路のより高い集積度を得るために、リソグラフィーにおける加工サイズの微細化がさらに進んでおり、近年では、 $0.5 \mu$  m以下の微細加工を安定的に行うことのできる技術が必要とされている。そのため、用いられるレジストにおいても、 $0.5 \mu$  m以下のパターンを精度良く形成することが必要である。しかし、従来の可視光線(700~400 nm)または近紫外線(400~300 nm)を用いる方法では、 $0.5 \mu$  m以下のパターンを精度良く形成することは極めて困難である。それ故、より波長の短い(300 nm以下)放射線を利用したリソグラフィー技術が検討されている。

【0003】このような放射線としては、水銀灯の輝線スペクトル(254nm)、KrFエキシマレーザー(248nm)などに代表される遠紫外線や、X線、電子線などを挙げることができる。これらのうち、特に注目されているのがエキシマレーザーである。このため、使用されるレジストに関しても、エキシマレーザーにより0.5μm以下のパターンを高感度、高解像度で、パターンのプロファイルが良く、フォーカス許容性(放射 50

線照射時に焦点がずれても良好なパターンを保つことができる)、現像性(現像時のスカムや現像残りがない)、残膜性(現像時に膜減りしない)、接着性(現像時にレジストパターンが剥がれない)などの性能が優れていることが必要とされる。さらに、最近では、放射線照射によって酸を発生させ、その触媒作用により感度を向上させる「化学増幅型レジスト」が提案されている。これらのレジストにおいては、一般に、感度は良好であるが、安定性に問題があり、例えば放射線照射から現像までの時間や放射線照射後の加熱温度の違いなどにより性能が大きく変化するという問題がある。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、新規な感放射線性樹脂組成物を提供することにある。本発明の他の目的は、微細加工を安定的に行うことができ、高感度、高解像度で、パターンプロフファイルが良く、フォーカス許容性、現像性、残膜性、密着性などの性能に優れ、安定性も良好であり、レジストとして好適な、感放射線性樹脂組成物を提供することにある。本発明のさらに他の目的は以下の説明から明らかとなろう。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明によれば、本発明の上記目的および利点は、第1に、(1)アルカリ可溶性樹脂(以下、「樹脂(A)」という)、(2)感放射線性酸形成剤(以下、「酸形成剤」という)、(3)(1)のアルカリ可溶性樹脂のアルカリ溶解性を制御する性質を有し、そして酸の存在下で分解されて(1)のアルカリ可溶性樹脂のアルカリ溶解性制御効果を低下もしくは消失する性質または(1)のアルカリ可溶性樹脂のアルカリ溶解性を促進する性質を発現する化合物(以下、「溶解制御剤」という)、および(4)含窒素塩基性化合物を含有することを特徴とするポジ型感放射線性樹脂組成物(以下、「第1の発明」という)により達成される。

【0006】また、本発明によれば、本発明の上記目的および利点は、第2に、(1) 置換メチル基、1-置換エチル基、ゲルミル基、アルコキシカルボニル基およびアシル基から選ばれる少なくとも1種の酸解離性基を有するアルカリ不溶性または難溶性樹脂で、上記の基が酸の解離したときにアルカリ可溶性である樹脂(以下、「樹脂(B)」という)、(2)酸形成剤、および(3)含窒素塩基性化合物を含有することを特徴とするポジ型感放射線性樹脂組成物(以下、「第2の発明」という)により達成される。

【0007】更に、本発明によれば、本発明の上記目的および利点は、第3に、(1)樹脂(A)、(2)酸形成剤、(3)酸の存在下で(1)のアルカリ可溶性樹脂を架橋する化合物(以下、「架橋剤」という)、および(4)含窒素塩基性化合物を含有することを特徴とするネガ型感放射線性樹脂組成物(以下、「第3の発明」と

いう)により達成される。

【0008】以下、本発明の組成物について説明する。

【0009】樹脂(A)

第1の発明および第3の発明で使用される樹脂(A)は、アルカリ現像液に可溶であるという性質を有するものであれば特に限定されない。従って、アルカリ現像液\*

\*と親和性を示す官能基、例えばフェノール性水酸基、カルボキシル基などの酸性官能基を有する樹脂であればよい。好適な樹脂(A)としては、例えば下記式(1) 【0010】

$$\begin{array}{c}
R^{\circ 1} \\
\hline
C-CH_2 \\
\hline
R^{\circ 2}
\end{array}$$
... (1)

ここで、 $R^{o_1}$ は水素原子またはメチル基であり、 $R^{o_2}$ は、ヒドロキシル基、カルボキシル基、 $-R^{o_3}$ COOH、 $-OR^{o_3}$ COOH または  $-OCR^{o_3}$ COOH であり、そして  $OR^{o_3}$ は  $-(CH_2)_n$  であり、 $R^{o_3}$ は  $-(CH_2)_n$  であり、 $-(CH_2)_n$ 

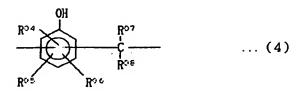
【0011】で表わされる繰返し単位、下記式(2)※【化2】【0012】※

ここで、R<sup>01</sup>の定義は上記式(1)に同じである、

【0013】で表わされる繰返し単位、下記式(3) 30★【化3】 【0014】 ★

 【0015】で表わされる繰返し単位および下記式
 ☆【0016】

 (4)
 ☆【化4】



ここで、 $R^{04}$ 、 $R^{05}$ 、 $R^{06}$ 、 $R^{07}$ および $R^{08}$ は、同一もしくは異なり、水素原子または炭素数 $1\sim4$ のアルキル基である、

【0017】で表わされる繰返し単位の少なくとも1つ 【0018】本発明における樹脂(A)は、式(1)、の繰返し単位を含有する樹脂を挙げることができる。 50 式(2)、式(3)または式(4)で表わされる繰返し

単位のみで構成されてもよいし、またその他の繰返し単 位を有してもよい。ここにおけるその他の繰返し単位と しては、例えば無水マレイン酸、フマロニトリル、アク リルアミド、アクリロニトリル、ビニルピリジン、ビニ ルピロリドン、ビニルイミダゾール、ビニルアニリンな どの二重結合を含有するモノマーの二重結合が開裂した 繰返し単位を挙げることができる。

【0019】本発明の樹脂(A)における式(1)、式 (2)、式(3) および式(4) で表わされる繰返し単 位の含有量は含有されるその他の繰返し単位により一概 10 に決定できないが、通常、15モル%以上、好ましくは 20モル%以上である。本発明の樹脂(A)の分子量 は、ゲルパーミエーションクロマトグラフィー(GP C) で測定したポリスチレン換算重量平均分子量(以 下、「Mw」という)が、好ましくは1,000~15 0,000、特に好ましくは3,000~100,000 である。

【0020】本発明の樹脂(A)を製造する方法として は、例えば対応するビニルモノマーを重合して得ること もできるし、あるいはフェノール類とアルデヒド類を重 20 縮合して得ることもできる。これらの樹脂(A)のう ち、式(1)または式(2)で表わされる繰返し単位を 含有する樹脂は、水素添加率が70%以下、好ましくは 50%以下、さらに好ましくは40%以下の水素添加物 として用いることもできる。

#### 【0021】樹脂(B)

第2の発明で用いられる樹脂(B)は、上述の樹脂 (A)の酸性官能基のフェノール性水酸基またはカルボ キシル基の水素原子を置換メチル基、1-置換エチル 基、ゲルミル基、アルコキシカルボニル基およびアシル 30 基から選ばれる少なくとも1種の酸解離性基(以下、

「置換基B」とする)で置換したアルカリ不溶性または 難溶性樹脂である。ここで、酸解離性基とは酸の存在下 で解離することが可能な基のことをいう。

【0022】置換基Bの具体例としては、メトキシメチ ル基、メチルチオメチル基、メトキシエトキシメチル 基、テトラヒドロピラニル基、テトラヒドロフラニル 基 テトラヒドロチオフラニル基 テトラヒドロチオピ ラニル基、ベンジルオキシメチル基、フェナシル基、ブ ロモフェナシル基、メトキシフェナシル基、αーメチル 40 含有化合物、キノンジアジド化合物、スルホン化合物、 フェナシル基、シクロプロピルメチル基、シクロヘキシ ル基、シクロペンチル基、ベンジル基、トリフェニルメ チル基、ジフェニルメチル基、ブロモベンジル基、ニト ロベンジル基、メトキシベンジル基、ピペロニル基など の置換メチル基; 1-メトキシエチル基、1-エトキシ エチル基、イソプロピル基、tーブチル基、1,1-ジ メチルプロビル基などの1-置換エチル基;トリメチル ゲルミル基、トリエチルゲルミル基、t-ブチルジメチ ルゲルミル基、イソプロピルジメチルゲルミル基、フェ

ニルジメチルゲルミル基などのゲルミル基;メトキシカ ルボニル基、エトキシカルボニル基、t-ブトキシカル ボニル基などのアルコキシカルボニル基;および

【0023】アセチル基、プロピオニル基、ブチリル 基 ヘプタノイル基 ヘキサノイル基 バレリル基 ピ バロイル基、イソバレリル基、ラウリロイル基、ミリス トイル基、パルミトイル基、ステアロイル基、オキサリ ル基、マロニル基、スクシニル基、グルタリル基、アジ ポイル基、ピペロイル基、スベロイル基、アゼラオイル 基、セバコイル基、アクリロイル基、プロピオロイル 基 メタクリル基 クロトノイル基 オレオイル基 マ レオイル基、フマロイル基、メサコノイル基、カンホロ イル基、ベンゾイル基、フタロイル基、イソフタロイル 基 テレフタロイル基 ナフトイル基 トルオイル基 ヒドロアトロポイル基、アトロポイル基、シンナモイル 基、フロイル基、テノイル基、ニコチノイル基、イソニ コチノイル基、p-トルエンスルホニル基、メシル基な どのアシル基を挙げることができる。

【0024】その中でもtーブチル基、ベンジル基、テ トラヒドロフラニル基、テトラヒドロピラニル基、テト ラヒドロチオフラニル基、テトラヒドロチオピラニル基 またはtーブトキシカルボニル基が好ましい。

【0025】置換基Bの導入は、樹脂(A)の酸性官能 基を介して行なわれ、置換基Bは、樹脂(A)の全酸性 官能基に対し、好ましくは15~100%、さらに好ま しくは30~100%導入する。樹脂(B)の分子量は GPCで測定したMwが好ましくは $1,000\sim150$ . 000、特に好ましくは3,000~100,000であ る。

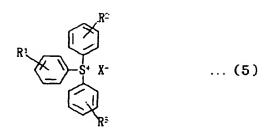
【0026】樹脂(B)はアルカリ不溶性または難溶性 である。アルカリ難溶性とは、第2の発明を用いて形成 されるレジスト皮膜にパターンを形成する際の好適なア ルカリ現像条件において、当該レジスト皮膜の代わりに 樹脂(B)のみの皮膜を用いて同様のアルカリ現像を行 った場合に、樹脂(B)が初期膜厚の50%以上の膜厚 で、当該操作後に残存する性質をいう。

#### 【0027】酸形成剤

本発明で用いられる放射線に感応して酸を発生する化合 物、すなわち酸形成剤は、例えばオニウム塩、ハロゲン スルホン酸化合物、ニトロベンジル化合物などであり、 具体的には以下に示す化合物を例示することができる。 【0028】オニウム塩としては、例えばヨードニウム 塩、スルホニウム塩、ホスホニウム塩、ジアゾニウム 塩、アンモニウム塩などを挙げることができ、好ましく は下記式(5)

[0029]

【化5】



ここで、 $R^1$ 、 $R^2$ および $R^3$ は、同一または異なり、水素原子、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、炭素数 $1\sim 4$ のアルキル基または炭素数 $1\sim 4$ のアルコキシ基であり、そして

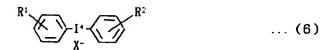
XdSbF6, AsF6, PF6, BF4, CF5CO2, C1O4, CF3SO5,



を示す。また、R4は水素原子、アミノ基、アニリノ基、

炭素数1~4のアルキル基または炭素数1~4のアルコキシ基であり、 R<sup>5</sup>およびR<sup>6</sup>は炭素数1~4のアルコキシ基であり、R<sup>7</sup>は水素原子、ア ミノ基、アニリノ基、炭素数1~4のアルキル基または炭素数1~のア ルコキシ基である、

【0030】で表わされる化合物 下記式(6) \* 【化6】 【0031】 \*



ここで、R1、R2およびXの定義は上記式(5)に同じである、

【0032】で表わされる化合物および下記式(7)※【化7】【0033】※40

$$\begin{array}{c}
R^1 \\
\stackrel{R^2}{\swarrow} \stackrel{t}{\searrow} N \\
\stackrel{R^3}{\swarrow} \qquad \qquad \dots \qquad (7)
\end{array}$$

ここで、 $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^3$ およびXの定義は上記式(5)に同じである、

【0034】で表わされる化合物を挙げることができる。

ヘテロ環状化合物などを挙げることができ、好ましくは下記式(8)

【0035】ハロゲン含有化合物としては、例えばハロ

[0036] [化8]

アルキル基含有炭化水素系化合物、ハロアルキル基含有 50

ここで、Raはトリクロロメチル基、フェニル基、メトキシフェニル基、 ナフチル基またはメトキシナフチル基である、

【0037】で表わされる化合物および下記式(9) \* 【化9】 [0038] \* 10

ここで、R<sup>9</sup>、R<sup>16</sup>およびR<sup>11</sup>は、同一または異なり、水素原子、ハロゲン 原子、メチル基、メトキシ基または水酸基である、

【0039】で表わされる化合物を挙げることができ る。

※どを挙げることができ、好ましくは下記式 (10) [0041]

【0040】キノンジアジド化合物としては、例えばジ

【化10】

アゾベンゾキノン化合物、ジアゾナフトキノン化合物な※

【0042】で表わされる化合物、下記式(11)

★【化11】

[0043]

... (11)

【0044】で表わされる化合物 下記式 (12)

☆【化12】

[0045]

众

$$\left( \begin{array}{c} \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \\ \end{array} \right)_{\mathbf{q}} \cdots (12)$$

ここで、R10は -CH2-、-C(CH5)2-、-Ё- または -S02- であり、 qは $1\sim6$ の整数であり、そしてrは $0\sim5$ の整数である、ただしqとrの 合計は1~6である、

11

[0046] で表わされる化合物および下記式(13) \* 【化13】

[0047]

$$\left(\begin{array}{c} R^{13} \\ C \\ R^{14} \end{array}\right) \begin{pmatrix} SO_3 \\ (OH)_{\mathfrak{t}} \end{pmatrix}_{\mathfrak{S}} \dots (13)$$

ここで、R13は水素原子またはメチル基であり、R14は -CH2-、

 $-C(CH_s)_{2^-}$ 、-C- または  $-SO_{2^-}$  であり、 sは  $1\sim 6$  の整数であり、そして t は  $0\sim 5$  の整数である、ただし s と t の 合計は  $1\sim 6$  である、

【0048】で表わされる化合物を挙げることができる。

※でき、好ましくは下記式(14)

[0050]

【0049】スルホン化合物としては、例えば $\beta$ -ケトスルホン、 $\beta$ -スルホニルスルホンなどを挙げることが%20

【化14】

0ここで、Yは一C- または  $-S0_2$ - であり、  $R^{15}$ 、 $R^{16}$ 、 $R^{17}$ および $R^{16}$ は、同一または異なり、炭素数 $1\sim 4$ のアルキル基またはハロゲン原子であり、そして nは $0\sim 3$ の整数である、

【0051】で表わされる化合物を挙げることができる。

ルホネート化合物などを挙げることができ、好ましくは下記式 (15)

【0052】ニトロベンジル化合物としては、例えばニ

[0053]

トロベンジルスルホネート化合物、ジニトロベンジルス

【化15】

$$(NO_2)_{\nu}$$
 $R^{20}$ 
 $CH-OSO_2-R^{21}$ 
... (15)

ここで、R<sup>19</sup>は炭素数1~4のアルキル基であり、R<sup>20</sup>は水素原子またはメチル基であり、

$$R^{21}$$
id  $R^{22}$   $R^{23}$   $R^{24}$   $R^{24}$   $R^{24}$   $R^{24}$   $R^{25}$   $R^{25}$ 

(ただし、 $R^{22}$ は水素原子またはメチル基であり、そして $R^{23}$ および $R^{24}$ は、同一または異なり、炭素数 $1\sim4$ のアルコキシ基である)、そしてnは $1\sim3$ の整数である、

【0054】で表わされる化合物を挙げることができる。

\*ル、アリールスルホン酸エステル、イミノスルホナートなどを挙げることができ、好ましくは下記式 (16)

14

【0055】スルホン酸化合物としては、例えばアルキ 20 【0056】 ルスルホン酸エステル、ハロアルキルスルホン酸エステ\* 【化16】

ここで、 $R^{25}$ および $R^{26}$ は、同一または異なり、水素原子または炭素数 $1\sim 4$ のアルキル基であり、そして $R^{27}$ および $R^{26}$ は、同一または異なり、水素原子、炭素数 $1\sim 4$ のアルキル基または炭素数 $6\sim 2$ 0のアリール基である、

【0057】で表わされる化合物、下記式(17) ※ 【化17】 【0058】 ※

$$R^{29}$$
  $SO_3-C=N$   $R^{30}$  ... (17)

ここで、 $R^{29}$ は水素原子または炭素数 $1\sim4$ のアルキル基であり、そして  $R^{30}$ および $R^{31}$ は、同一または異なり、炭素数 $1\sim4$ のアルキル基または炭 索数 $6\sim2$ 0のアリール基であるか、あるいは $R^{30}$ と $R^{31}$ は互いに結合して それらが結合している窒素原子と一緒になって環を形成していてもよい、

【0059】で表わされる化合物および下記式(18) ★ 【化18】 【0060】 ★

ここで、乙はフッ素原子もしくは塩素原子である、

【0061】で表わされる化合物を挙げることができ 50 る。

【0062】これらのうち、オニウム塩およびキノンジアジド化合物が特に好ましい。これら酸形成剤の配合量は、上記樹脂(A)または樹脂(B)100重量部に対して、好ましくは1~70重量部であり、より好ましくは3~50重量部、さらに好ましくは3~20重量部である。1重量部未満では、十分なパターン形成能力が得られ難く、また70重量部を超えると、スカムを生じ易くなる。

# 【0063】溶解制御剤

第1の発明では、溶解制御剤が用いられる。該溶解制御 10 剤は、それ自体がアルカリ可溶性樹脂のアルカリ溶解性 を制御する効果を有し、そして酸の存在下で分解、例えば加水分解されてアルカリ可溶性樹脂のアルカリ溶解性 制御効果を低下もしくは消失する性質または樹脂(A)のアルカリ溶解性を促進する性質を発現する化合物であ\*

\*る。

【0064】該溶解制御剤としては、例えば酸性官能基に酸存在下にて遊離しうる置換基を導入した化合物が挙げられる。該置換基としては、特に限定されないが、例えば前記樹脂(B)にて述べた置換基Bまたはシリル基が挙げられる。ここで、シリル基の具体例としてはトリメチルシリル基、トリエチルシリル基、tープチルジメチルシリル基、イソプロピルジメチルシリル基、フェニルジメチルシリル基などが挙げられる。

10 【0065】該溶解制御剤は、低分子化合物でもよく、 高分子化合物でもよい。例えば、下記式 (19)、式 (20)、式 (21)、式 (22)および式 (23) 【0066】 【化19】

... (19)

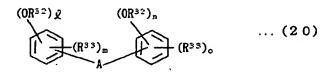
ここで、R<sup>32</sup>は、同一でも異なっていてもよく、置換メチル基、1 −置換エチル基、ゲルミル基、シリル基、アルコキシカルボニル基、アシル基から選ばれる基であり、

R35は複数存在する場合は、炭素数4以下のアルキル基、フェニル基または ナフチル基であり、そして

 $\ell$ およびmは、 $\ell+m \le 6$ および $1 \le \ell$ を満たす0以上の整数である、

[0067]

※ ※【化20】



ここで、 $R^{32}$ および $R^{33}$ の定義は上記式(19)に同じであり、 $\ell$ 、m、nおよび o は、 $\ell + m \le 5$ 、 $n + o \le 5$ および  $1 \le \ell + n$  を満たす 0 以上の整数であり、

である(ただし、 $R^{52}$ の定義は上記式(19)に同じであり、 $R^{34}$ および  $R^{35}$ は水素原子、炭素数 6 以下のアルキル甚、アシル甚、フェニル甚または ナフチル基であり、そして r は  $0 \le r \le 4$  を満たす整数である)、

[0068]

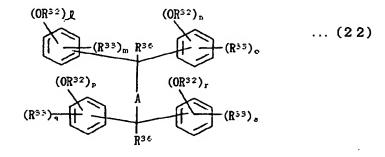
$$(0R^{32}) \qquad (0R^{32})_n \qquad (R^{33})_o \qquad (21)$$

$$(0R^{52})_p \qquad (R^{53})_q$$

ここで、 $R^{32}$ および $R^{53}$ の定義は上記式(19)に同じであり、  $\ell$ 、m、n、o、pおよびqは、 $\ell+m$  $\le 5$ 、o+n $\le 5$ 、p+q $\le 5$ および 1 $\le \ell+n+p$ を満たす 0以上の整数であり、そして  $R^{56}$ は水素原子、炭素数 4以下のアルキル基またはフェニル基である、

[0069]

\* \* 【化22】



ここで、 $R^{32}$ 、 $R^{33}$ および $R^{36}$ の定義は上記式(20)に同じであり、 $\ell$ 、m、n、o、p、q、rおよびs は、 $\ell+m\leq 5$ 、 $n+o\leq 5$ 、 $p+q\leq 5$ 、 $r+s\leq 5$ および $1\leq \ell+n+p+r$ を満たす0以上の整数であり、

である(ただし、 $R^{32}$ の定義は上記式(20)に同じであり、 $R^{34}$ および  $R^{35}$ は水素原子、炭素数 6 以下のアルキル基、フェニル基またはナフチル基 であり、そしてx は  $0 \le x \le 4$  を満たす整数である)、

[0070]

【化23】

ここで、 $R^{32}$ 、 $R^{34}$ および $R^{34}$ の定義は上記式(21)に同じであり、そして  $\ell$  、 m、 n、 o、 p、 q、 rおよび s は、  $\ell$  + m  $\leq$  5、 p + q  $\leq$  5、 n + o  $\leq$  5、 r + s  $\leq$  4 および 1  $\leq$   $\ell$  + n + r + p を満たす 0 以上の整数である、

【0071】で表わされる化合物ならびに樹脂(A)に 置換基Bまたはシリル基を導入した樹脂(以下、「樹脂 C」という)を挙げることができる。

【0072】該溶解制御剤の配合量は、第1の発明において、樹脂(A)100重量部に対して、好ましくは $5\sim150$ 重量部、さらに好ましくは $5\sim100$ 重量部である。

# 【0073】含窒素塩基性化合物

本発明に使用される含窒素塩基性化合物は、好ましくは下記式(24)~(28)で表わされる構造の少なくとも1種の構造を分子内に有する化合物である。

[0074]

【化24】

ここで、 $R^{37}$ 、 $R^{38}$ および $R^{39}$ は、同一または異なり、水素原子、炭素数  $1\sim6$ のアルキル基、炭素数  $1\sim6$ のアミノアルキル基、炭素数  $1\sim6$ の ヒドロキシアルキル基または炭素数  $6\sim2$ 0の置換もしくは非置換のアリール基であり、ここで $R^{41}$ と $R^{42}$ は互いに結合して環を形成してもよい。

(式中、 $R^{40}$ 、 $R^{41}$ 、 $R^{42}$ および $R^{43}$ は、同一または異なり、炭素数 $1\sim6$ のアルキル基を示す)

【0075】式(24)で表わされる構造を分子内に有する化合物の具体例としては、アンモニア、トリエチルアミン、トリプロピルアミン、トリブチルアミン、アニリン、Nーメチルアニリン、3ーメチルアニリン、4ーメチルアニリン、4ーニトロアニリン、1ーナフチルアミン、2ーナフチルアミン、ジフェニルアミン、エチレンジアミン、テトラメチレンジアミン、ペキサメチレンジアミン、ピロリジン、ピペリジンなどが挙げられる。

【0076】式(25)で表わされる構造を分子内に有する化合物の具体例としては、イミダゾール、4-メチルイミダゾール、4-メチルー2-フェニルイミダゾール、チアベンダゾールなどが挙げられる。

【0077】式(26)で表わされる構造を分子内に有する化合物の具体例としては、ピリジン、2-メチルピリジン、4-エチルピリジン、1-メチルー4-フェニルピリジン、2-(1-エチルプロピル)ピリジン、ニ 40コチン酸アミド、ジベンゾイルチアミン、四酪酸リボフラミンなどが挙げられる。

【0078】式(27)で表わされる構造を分子内に有する化合物の具体例としては、4,4' ージアミノジフェニルメタン、4,4' ージアミノジフェニルエーテル、3,4' ージアミノジフェニルエーテル、4,4' ージアミノベンゾフェノン、4,4' ージアミノジフェニルアミン、2,2ーピス(4-アミノフェニル)プロパン、2-(3-アミノフェニル)-2-(4-アミノフェニル)プロパン、2-(4-アミノフェニル) ー2-50

(3-ヒドロキシフェニル)プロパン、2-(4-アミノフェニル)-2-(4-ヒドロキシフェニル)プロパン、1,4-ビス [1-(4-アミノフェニル)-1-メチルエチル]ベンゼン、1,3-ビス [1-(4-アミノフェニル)-1-メチルエチル]ベンゼンなどが挙げられる。

【0079】式(28)で表わされる構造を分子内に有する化合物の具体例としては、コハル酸ジメチルー1ー(2ーヒドロキシエチル)ー4ーヒドロキシー2,2,6,6ーテトラメチルピペリジン重縮合物、ポリ{[6ー(1,1,3,3ーテトラメチルブチル)イミノー1,3,5ートリアジンー2,4ージイル][(2,2,6,6ーテトラメチルー4ーピペリジル)イミノ]ヘキサメチレン[(2,2,6,6ーテトラメチルー4ーピペリジル)イミノ])、2ー(3,5ージーtーブチルー4ーヒドロキシベンジル)ー2ーnーブチルマロン酸ピス(1,2,2,6,6ーペンタメチルー4ーピペリジル)などが挙げられる。

【0080】これらの含窒素塩基性化合物は、単独であるいは2種以上一緒に用いられる。含窒素塩基性化合物はの使用量は、樹脂(A)または樹脂(B)100重量部に対し、通常、0.001~10重量部、好ましくは0.01~5重量部である。0.001重量部未満ではパターン形状および接着性が悪化する傾向があり、一方10重量部を超えると感度の低下や非露光部の現像性が悪化する傾向がある。

【0081】架橋剤

第3の発明では、架橋剤が用いられる。該架橋剤は、 酸、例えば放射線照射により生じた酸の存在下で樹脂

(A) を架橋する化合物である。上記性質を有する化合 物であれば、該架橋剤は特に限定されないが、例えば架 橋反応可能な置換基を有する芳香族化合物を好適なもの として挙げることができる。

【0082】例えば-C (R<sup>44</sup>R<sup>45</sup>) -OR<sup>46</sup>基を有す る芳香族化合物 [(但し、R44およびR45は、同一ある いは異なっていてもよく、水素原子あるいは炭素数1~ 4のアルキル基を表わし、R<sup>46</sup>は水素原子あるいは炭素 数1~5のアルキル基、アラルキル基、-NR47R48基 (但し、R<sup>47</sup>およびR<sup>48</sup>は、同一あるいは異なっていて もよく、炭素数1~4のアルキル基、ヘテロ原子を含有 あるいは非含有の原子数3~8のシクロ環を表わす)、 -COR<sup>49</sup>基(但し、R<sup>49</sup>は炭素数1~4のアルキル基 または炭素数6~14のアリール基を表わす)]、

【0083】-CO-R<sup>50</sup>を有する芳香族化合物(但 し、R50は水素原子あるいは炭素数1~4のアルキル基 を表わす)、 $-CR^{51}=CR^{52}R^{53}$ 基を有する芳香族化 合物(但しR<sup>51</sup>、R<sup>52</sup>およびR<sup>53</sup>は、同一あるいは異な 20 っていてもよく、水素原子あるいは炭素数1~4のアル キル基を表わす)などを挙げることができる。

【0084】これらの架橋反応可能な置換基としては、 例えばグリシジルエーテル基、グリシジルエステル基、 グリシジルアミノ基、メトキシメチル基、エトキシメチ ル基、ベンジルオキシメチル基、ジメチルアミノメチル 基、ジエトキシメチルアミノ基、モルホリノメチル基、 アセトキシメチル基、ベンゾイロキシメチル基、ホルミ ル基、アセチル基、ビニル基、イソプロペニル基などが 挙げられる。

【0085】上記置換基を有する芳香族化合物として は、例えばビスフェノールA系エポキシ化合物、ビスフ ェノールF系エポキシ化合物、ビスフェノールS系エポ キシ化合物、ノボラック系エポキシ化合物、レゾール樹 脂系エポキシ化合物、ポリヒドロキシスチレン系エポキ シ化合物、メチロール基含有メラミン樹脂、メチロール 基含有ベンゾグアナミン樹脂、メチロール基含有ユリア 樹脂、メチロール基含有フェノール樹脂、メチロール基 含有メラミン化合物、メチロール基含有フェノール化合 物、アルキルエーテル基含有メラミン樹脂、アルキルエ 40 ーテル基含有ベンゾグアナミン樹脂、アルキルエーテル 基含有ユリア樹脂、アルキルエーテル基含有フェノール 樹脂、アルキルエーテル基含有メラミン化合物、アルキ ルエーテル基含有フェノール化合物 カルボキシメチル 基含有メラミン樹脂、カルボキシメチル基含有ベンゾグ アナミン樹脂、カルボキシメチル基含有ユリア樹脂、カ ルボキシメチル基含有フェノール樹脂、カルボキシメチ ル基含有メラミン化合物、カルボキシメチル基含有フェ ノール化合物などが挙げられる。

脂、メチロール基含有フェノール化合物、メトキシメチ ル基含有メラミン化合物 メトキシメチル基含有フェノ ール化合物およびアセトキシメチル基含有フェノール化 合物が好ましい。

【0087】架橋剤としては、さらに、樹脂 (A) を上 記に示す架橋反応可能な置換基で修飾して、架橋剤とし ての性質を付与したものを有利に使用できる。その場合 の導入率は、樹脂(A)の酸性官能基の総量に対し、通 常、5~60%、好ましくは10~50%、さらに好ま しくは15~40%になるように調整される。5%以下 では、十分な架橋反応を起こすことが困難で残膜率の低 下、パターンの蛇行、膨潤などを招きやすく好ましくな い。また、60%以上では、樹脂(A)のアルカリ可溶 性の低下を招き現像性が悪化する傾向にある。

【0088】架橋剤の配合量は、樹脂(A)100重量 部に対して、好ましくは5~95重量部、特に好ましく は15~85重量部、さらに好ましくは20~75重量 部である。5重量部以下では、十分な架橋反応を起こす ことが困難で残膜率の低下、パターンの蛇行、膨潤など を招きやすい。また、95重量部以上では、スカムが多 く現像性が悪化する傾向にある。

【0089】本発明の組成物においては、さらに必要に 応じて、種々の添加剤を配合することができる。このよ うな添加剤としては、例えば塗布性、ストリエーション や乾燥塗膜形成後の放射線照射部の現像性などを改良す るための界面活性剤を挙げることができる。この界面活 性剤としては、例えばポリオキシエチレンラウリルエー テル、ポリオキシエチレンステアリルエーテル、ポリオ キシエチレンオレイルエーテル、ポリオキシエチレンオ 30 クチルフェノールエーテル、ポリオキシエチレンノニル フェノールエーテル、ポリエチレングリコールジラウレ ート、ポリエチレングリコールジステアレート、市販品 としては、例えばエフトップEF301、EF303. EF352 (新秋田化成 (株) 製)、メガファックスF 171、F173 (大日本インキ(株) 製)、フロラー ドFC430、FC431 (住友スリーエム (株) 製)、アサヒガードAG710、サーフロンS-38 2, SC101, SC102, SC103, SC10 4、SC105、SC106 (旭硝子 (株) 製)、オル ガノシロキサンポリマーKP341 (信越化学工業 (株) 製)、アクリル酸系またはメタクリル酸系(共) 重合体であるポリフローNo.75、No.95(共栄社 油脂化学工業(株)製)などが用いられる。

【0090】界面活性剤の配合量は、前記樹脂(A)ま たは樹脂(B)100重量部当り、通常、2重量部以下 である。その他の添加剤としては、ハレーション防止 剤、接着助剤、保安安定剤、消泡剤などを挙げることが

【0091】本発明の組成物は、前述した樹脂 (A) ま 【0086】このうち、メチロール基含有フェノール樹 50 たは酸形成剤および必要により配合される各種添加剤

を、それぞれ必要量、溶剤に溶解させることによって調 製される。

【0092】この際に用いられる溶剤としては、例えば エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリ コールモノエチルエーテル、エチレングリコールモノプ ロピルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテ ル、ジエチレングリコールジメチルエーテル、ジエチレ ングリコールジエチルエーテル、ジエチレングリコール ジプロピルエーテル、ジエチレングリコールジブチルエ ーテル、2ーメトキシエチルアセテート、2ーエトキシ 10 エチルアセテート、プロピレングリコールモノメチルエ ーテルアセテート、プロピレングリコールモノエチルエ ーテルアセテート、プロピレングリコールモノプロピル エーテルアセテート、トルエン、キシレン、メチルエチ ルケトン、2-ヘプタノン、3-ヘプタノン、4-ヘプ タノン、シクロヘキサノン、2-ヒドロキシプロピオン 酸メチル、2ーヒドロキシプロピオン酸エチル、2ーヒ ドロキシー2ーメチルプロピオン酸エチル、エトキシ酢 酸エチル、ヒドロキシ酢酸エチル、2-ヒドロキシ-3 ーメチルブタン酸メチル、3-メトキシブチルアセテー 20 ト、3-メチル-3-メトキシブチルアセテート、3-メチルー3ーメトキシブチルプロピオネート、3ーメチ ルー3ーメトキシブチルブチレート、酢酸エチル、酢酸 ブチル、アセト酢酸メチル、アセト酢酸エチル、3-メ トキシプロピオン酸メチル、3-エトキシプロピオン酸 エチル、ピルビン酸メチル、ピルビン酸エチル、N-メ チルピロリドン、N,Nージメチルホルムアミド、N,N ージメチルアセトアミドなどを挙げることができる。

【0093】また、これらの溶剤には、必要に応じてベンジルエチルエーテル、ジへキシルエーテル、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、アセトニルアセトン、イソホロン、カプロン酸、カプリル酸、1-オクタノール、1-ノナノール、ベンジルアルコール、酢酸ベンジル、安息香酸エチル、シュウ酸ジエチル、マレイン酸ジエチル、アーブチロラクトン、炭酸エチレン、炭酸プロピレン、フェニルセロソルブアセテートなどの高沸点溶剤を添加することもできる。

【0094】本発明の組成物は、上記の溶液の形でシリコンウェハーなどの基板上に塗布し、乾燥することによってレジスト膜を形成する。この場合、基板上への塗布は、例えば本発明の組成物を固体分濃度がで5~50重量%となるように前記の溶剤に溶解し、濾過した後、これを回転塗布、流し塗布、ロール塗布などにより塗布することによって行われる。

【0095】形成されたレジスト膜には、微細パターンを形成するために部分的に放射線が照射される。用いられる放射線には特に制限はなく、例えばエキシマレーザーなどの遠紫外線、シンクロトロン放射線などのX線、電子線などの荷電粒子線のような放射線が、使用される 50

酸形成剤の種類に応じて用いられる。放射線量などの照 射条件は、組成物の配合組成、各添加剤の種類などに応 じて適宜決定される。

【0096】本発明においては、レジストのみかけの感度等を向上させるために、放射線照射後に加熱を行なうことが好適である。この加熱条件は、組成物の配合組成、各添加剤の種類などによって異なるが、通常、30~200℃、好ましくは50~150℃である。

【0097】次いで行われる現像に使用される現像液としては、レジストパターンを得るためには、例えば水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウム、珪酸ナトリウム、メタ珪酸ナトリウム、アンモニア水、エチルアミン、nープロピルアミン、ジエチルアミン、ジーnープロピルアミン、トリエチルアミン、トリエタノールアミン、デトラメチルアンモニウムヒドロキシド、テトラエチルアンモニウムヒドロキシド、ピロール、ピペリジン、1,8ージアザビシクロ[5.4.0]-7ーウンデセン、1,5ージアザビシクロ[4.3.0]-5ーノナンなどを溶解してなるアルカリ性水溶液などを使用することができる。

【0098】また、上記現像液に水溶性有機溶媒、例えばメタノール、エタノールなどのアルコール類や界面活性剤を適宜添加したアルカリ性水溶液を現像液として使用することもできる。さらに現像液として、クロロホルム、ベンゼンなどを使用することができ、この場合はネガ型のレジストパターンを得ることができる。

[0099]

【実施例】以下、実施例により本発明をさらに詳しく説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。 実施例中、各種の特性は次のようにして評価した。

【0100】最適露光量

0.4 μmのラインアンドスペースが設計通りにパターン形成できる露光量。

#### 解像度

最適露光量を与えた時に分離しているラインアンドスペースの最小サイズ。

#### パターン形状

走査型電子顕微鏡を用い、レジストパターンの方形状断面の下辺長Aと上辺長Bを測定し、0.85≦B/A≦1である場合をパターン形状が良好であると判断した。ただし、パターン形状が裾を引いていたり、逆テーパー状になっている場合は、B/Aが上記範囲に入っていても不良と判断した。

#### 【0101】フォーカス許容性

ステッパの焦点をずらして露光した場合に、上記に定義 した良好なパターン形状を保つことができる焦点のずれ の範囲。

## 安定性

) 露光後、2時間放置してから露光後ベークを行い、最適

露光量およびパターン形状を評価した。

## 接着性

走査型電子顕微鏡を用い、レジストパターンの剝がれの 程度を調べた。

【0102】Mw:東ソー社製GPCカラム(G2000HXL2本、G3000HXL1本、G4000XL1本)を用い、流量1.0m1/分、溶出溶媒テトラヒドロフラン、カラム温度40℃の分析条件で、単分散ポリスチレンを標準とするゲルパーミエーションクロマトグラフ法により測定した。

### 【0103】 実施例1

ポリヒドロキシスチレン30gをテトラヒドロフランに溶解して、カリウムtーブトキシド10gを添加し、攪拌下、0℃において、ジーtーブチルカルボネート75gを滴下し、6時間反応した。反応終了後、この溶液を水中に滴下し、析出したポリマーを真空乾燥器にて50℃で一晩乾燥した。得られたポリマーは、Mw=30,000、Mw/Mn=1.60で、NMR測定の結果からフェノール性水酸基の水素の63%がtーブトキシカルボニル基で置換された構造であった。

【0104】このポリマー10gとトリフェニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート0.2gおよびジアミノジフェニルメタン0.02gを3ーメトキシプロピオン酸メチル31gに溶解した後、0.2μmのフィルターで濾過して組成物溶液を調製した。調製した組成物溶液を、シリコンウェハー上に塗布した後に、100℃で2分間ベーキングを行い、膜厚1.0μmのレジスト膜を形成した。

【0105】形成したレジスト膜にステッパーを用いて、波長248nmのエキシマレーザーを30mJ.cm<sup>-2</sup>照射した後、90℃で2分間露光後ベークを行い、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液で60秒間、23℃にて現像し、次いで水で30秒間リンスした。形成されたポジ型パターンは、表1に示したように良好な結果を与えた。さらにこのレジストパターンを150℃のホットプレート上で2分間加熱したところ、パターン形状の変化は認められなかった。

#### 【0106】比較例1

実施例1で用いた組成物溶液において、ジアミノジフェニルメタンを添加しない組成物溶液を調製し、エキシマ 40 レーザーの照射量を変化させた以外は同様にしてパターン形成を行った。結果を表1に示した。5 m J. c m<sup>-2</sup> 照射した場合に0.35μmのラインアンドスペースパターンが解像されたが、パターン上部において庇が張り出すような形状であった。また、露光から露光後ベークまでの間隔を2時間とした場合には、表面に不溶層が形成し、パターンを解像することができなかった。

#### 【0107】実施例2

ポリヒドロキシスチレン 54gをアセトンに溶解して、t-ブチルー $\alpha-$  プロモ酢酸 27g、炭酸カリウム 1050

gおよびヨウ化カリウム9gを添加し、攪拌下、還流を 続けながら、7時間反応した。反応終了後、この溶液を 水中に滴下し、析出したポリマーを真空乾燥器にて50 ℃で一晩乾燥した。得られたポリマーは、Mw=18, 000、Mw/Mn=1.87で、NMR測定の結果か らフェノール性水酸基の水素の22%がtーブチル酢酸 残基で置換された構造であった。

28

【0108】このポリマー10gとトリフェニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート0.1gおよび10 ニコチン酸アミド0.02gを3-メトキシプロピオン酸メチル31gに溶解した後、0.2μmのフィルターで濾過して組成物溶液を調製した。調製した組成物溶液を、シリコンウェハー上に塗布した後に、90℃で2分間ベーキングを行い、膜厚1.0μmのレジスト膜を形成した。

【0109】形成したレジスト膜にステッパーを用いて、波長248nmのエキシマレーザーを52mJ.cm<sup>-2</sup>照射した後、100℃で2分間露光後ベークを行い、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液で60秒間、23℃にて現像し、次いで水で30秒間リンスした。形成されたポジ型パターンは、表1に示したように良好な結果を与えた。さらにこのレジストパターンを150℃のホットプレート上で2分間加熱したところ、パターン形状の変化は認められなかった。

# 【0110】比較例2

実施例2で用いた組成物溶液において、ニコチン酸アミドを添加しない組成物溶液を調製し、同様にパターン形成を行った。表1に示したように、表面に不溶層が形成し、パターンを形成することができなかった。

#### 【0111】実施例3

マレイン酸とスチレンとの共重合体107gを酢酸エチルに溶解して、3,4-ジヒドロ-2H-ピラン50gとp-トルエンスルホン酸0.1gを添加し、攪拌下、5℃において、3時間反応した。反応終了後、この溶液を蒸留水と混合し、分液ロートを用いてp-トルエンスルホン酸を抽出した後、ヘキサン中に滴下し、析出したポリマーを真空乾燥器にて50℃で一晩乾燥した。得られたポリマーは、Mw=11,000、Mw/Mn=2.1で、NMR測定の結果からマレイン酸のカルボン酸のうち52%がテトラヒドロピラニル基で置換された構造であった。

【0112】このポリマー10gとトリフェニルスルホニウムヘキサフロロアンチモネート0.2gおよびチアベンダゾール0.03gを3ーメトキシプロピオン酸メチル31gに溶解した後、0.2μmのフィルターで濾過して組成物溶液を調製した。調製した組成物溶液を、シリコンウェハー上に塗布した後に、100℃で2分間ベーキングを行い、膜厚1.0μmのレジスト膜を形成した。

【0113】形成したレジスト膜にステッパーを用い

て、波長248nmのエキシマレーザーを38mJ.cm<sup>-2</sup>照射した後、90℃で2分間露光後ベークを行い、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液で60秒間、23℃にて現像し、次いで水で30秒間リンスした。形成されたポジ型パターンは、表1に示したように良好な結果を与えた。さらにこのレジストパターンを140℃のホットプレート上で2分間加熱したところ、パターン形状の変化は認められなかった。

#### 【0114】比較例3

#### 【0115】実施例4

クレゾールノボラック(mー/pー=6/4)54gをアセトンに溶解して、tーブチルーαーブロモ酢酸27g、炭酸カリウム10gおよびヨウ化カリウム9gを添加し、撹拌下、還流を続けながら、7時間反応した。反応終了後、この溶液を水中に滴下し、析出したポリマーを真空乾燥器にて50℃で一晩乾燥した。得られたポリマーは、Mw=5,600、Mw/Mn=4.8で、NMR測定の結果からフェノール性水酸基の水素の22%がtーブチル酢酸残基で置換された構造であった。

【0116】このポリマー10gとトリフェニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート0.1gおよびニコチン酸アミド0.02gを3ーメトキシプロピオン酸メチル31gに溶解した後、 $0.2\mu$ mのフィルターで濾過して組成物溶液を調製した。調製した組成物溶液を、シリコンウェハー上に塗布した後に、90℃で2分間ベーキングを行い、膜厚 $1.0\mu$ mのレジスト膜を形成した。

【0117】形成したレジスト膜にステッパーを用いて、波長248nmのエキシマレーザーを31mJ/cm<sup>-2</sup>照射した後、100℃で2分間露光後ベークを行

い、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液で6 0秒間、23℃にて現像し、次いで水で30秒間リンス した。形成されたポジ型パターンは、表1に示したよう に良好な結果を与えた。さらにこのレジストパターンを 150℃のホットプレート上で2分間加熱したところ、 パターン形状の変化は認められなかった。

#### 【0118】実施例5

ポリヒドロキシスチレン (Mw=9,000) 10g、2,6-ビスメチロール-p-クレゾール4g、トリフェニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート <math>0.3gおよびジアミノジフェニルエーテル0.03gを3-メトキシプロピオン酸メチル31gに溶解した後、 $0.2\mu$ mのフィルターで濾過して組成物溶液を調製した。調製した組成物溶液を、シリコンウェハー上に塗布した後に、90で2分間ベーキングを行い、膜厚1. $0\mu$ mのレジスト膜を形成した。

【0119】形成したレジスト膜にステッパーを用いて、波長248nmのエキシマレーザーを15mJ.cm<sup>-2</sup>照射した後、100℃で2分間露光後ベークを行い、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液で60秒間、23℃にて現像し、次いで水で30秒間リンスした。形成されたネガ型パターンは、表1に示したように良好な結果を与えた。さらにこのレジストパターンを150℃のホットプレート上で2分間加熱したところ、パターン形状の変化は認められなかった。

#### 【0120】比較例4

実施例 5 で用いた組成物溶液において、ジアミノジフェニルエーテルを添加しない組成物溶液を調製し、エキシマレーザーの照射量を変化させた以外は実施例 5 と同様にしてパターン形成を行った。結果を表 1 に示した。 5 mJ. c m $^{-2}$  照射した場合に、 $0.4~\mu$  mのラインアンドスペースパターンが解像されたが、パターン表面において異物(直径  $0.02\sim0.05~\mu$  m程度の粒子状の突起物)が生成し、微細加工には好ましくない形状であった。また、露光から露光後ベークまでの間隔を 6 時間とした場合には、5 mJ. c m $^{-2}$  の露光量では、設計寸法  $0.4~\mu$  mのパターンが  $0.6~\mu$  mで形成されていた。

[0121]

【表1】

	路光	直後に露光後	露光直後に露光後ペークを行った場合	7場合			安定性
	最遊露光量	解徵度	パターン形状接着性	接着性	フォーカス	和商館光面	ジャーン形状
	(m J · c m <sup>-2</sup> ) (µm)	(m m)	•		(m m)	(m J · c m-2)	<b>.</b>
实施例1	30	0.3	韓	盘	1.2	2.9	瘤
实施例2	27	0.3	瘤	超	1.5	25	師
実施例3	စ	0.3	遊	崩	1.2	ထ	館
其施例4	31	0.3	與	廚	1.2	30	與
其他例5	15	0.35	商	盘	1.2	11 8	與
比较例1	വ	0.35	石良	不良	9.0	1	形成できず
比较例2	ı	ı	石度	ı	ı	1	別なできず
比較例3	10	0.4	猫	不良	0.3	1	が が が が
比较图4	ئ	0.4	類	郎	0.9	က	異物

\*好であり、特にエキシマーレーザーなどの遠紫外線以下 40 の波長の放射線の照射にも好適に使用される感放射線性 樹脂組成物を提供する。

フロントページの続き

(51) Int.Cl.5 G O 3 F 7/038 H O 1 L 21/027

FΙ

技術表示箇所

(72)発明者 三浦 孝夫

東京都中央区築地二丁目11番24号 日本合成ゴム株式会社内